

电子信息材料与器件教育部工程研究中心（桂林电子科技大学）文件

电子信息材料与器件教育部工程研究中心[2021]1 号

关于下达电子信息材料与器件教育部工程研究中心 2020 年度基金课题的通知

有关单位：

根据《电子信息材料与器件教育部工程研究中心科学技术发展规划》和《电子信息材料与器件教育部工程研究中心基金课题申请指南》的精神，经申请人申请、中心技术委员会评审，并经公示，决定批准“基于广西锆、钛特色资源的关键电子粉体材料及器件产业化研究”等 17 项为 2020 年度基金课题。研究经费一次下拨，重点项目下拨经费为 10-20 万元/项；一般项目下拨经费为 2 万元/项，总计 120 万元。

附件：电子信息材料与器件教育部工程研究中心 2020 年度基金
课题清单

电子信息材料与器件教育部工程研究中心
(桂林电子科技大学)

2021 年 4 月 22 日

主题词：工程研究中心 课题 自主研究

抄送：广西科技厅基础研究处 桂林电子科技大学科研院

电子信息材料与器件教育部工程研究中心 2021年4月22日印发

(共印4份)

附件：电子信息材料与器件教育部工程研究中心 2020 年度基金课题清单

序号	项目名称	合同编号	课题类型	起止年月	课题负责人	资助总经费 (万元)
1	基于广西锗、钛特色资源的关键电子粉体材料及器件产业化研究	EIMD-AA202001	重点项目	2021.02-2024.01	朱归胜	20
2	高密度半导体器件封装关键技术及产业化应用	EIMD-AA202002	重点项目	2021.02-2024.01	杨道国	20
3	分布式太阳能光热净水系统的研究及示范	EIMD-AA202003	重点项目	2021.02-2024.01	苗蕾	15
4	高性能稀土永磁材料的设计、制备及磁性能研究	EIMD-AA202004	重点项目	2021.02-2024.01	王江	15
5	仿生结构锂离子电池材料设计及其产业化	EIMD-AA202005	重点项目	2021.02-2024.01	俞兆喆	10
6	铝基均温板的传热调控方法和应用推广	EIMD-AA202006	重点项目	2021.02-2024.01	张平	10
7	BGA 类封装激光植球技术及其工程应用	EIMD-AA202007	重点项目	2021.02-2024.01	潘开林	10
8	锡、铟掺杂室温高性能硅锗基热电器件研究	EIMD-AB202001	一般项目	2021.02-2023.01	彭英	2
9	四方相纳米钛酸钡粉体的产业化制备技术与性能研究	EIMD-AB202002	一般项目	2021.02-2023.01	赵昀云	2
10	Nb-Ru-X 三元系相图、相结构研究	EIMD-AB202003	一般项目	2021.02-2023.01	龙乾新	2
11	基于 NiFe 层状双金属氢氧化物 (LDHs) /石墨炔(GDY) 碱性环境分解水性能与界面研究	EIMD-AB202004	一般项目	2021.02-2023.01	张豆豆	2

12	电子封装 Sn 基无铅微焊点在低温下的蠕变变形与失效机制研究	EIMD-AB202005	一般项目	2021.02-2023.01	李望云	2
13	轻质金属有机/无机杂化复合氢化物的创制与储氢性能	EIMD-AB202006	一般项目	2021.02-2023.01	邱树君	2
14	高密度电子封装器件非均质各向异性微焊点力学及电迁移失效机理研究	EIMD-AB202007	一般项目	2021.02-2023.01	秦红波	2
15	基于电射流打印的硅片键合方法研究	EIMD-AB202008	一般项目	2021.02-2023.01	陈小勇	2
16	稀土磁性高熵合金的设计、磁性能及其应用研究	EIMD-AB202009	一般项目	2021.02-2023.01	王成磊	2
17	碲化铅热电器件电界面材料的制备与高温钎焊工艺研究	EIMD-AB202010	一般项目	2021.02-2023.01	胡晓凯	2
合计						120